



# Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN23850X

Issue Date:20 Oct 2021

<b>Title of Change:</b>	CDAF qualification at Hana Thailand for big die size	
<b>Proposed First Ship date:</b>	27 Jan 2022 or earlier if approved by customer	
<b>Contact Information:</b>	Contact your local onsemi Sales Office or <a href="mailto:Naruedol.Srisamran@onsemi.com">Naruedol.Srisamran@onsemi.com</a>	
<b>PCN Samples Contact:</b>	Contact your local onsemi Sales Office or < <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
<b>Additional Reliability Data:</b>	Contact your local onsemi Sales Office or <a href="mailto:Lalan.Ortega@onsemi.com">Lalan.Ortega@onsemi.com</a>	
<b>Type of Notification:</b>	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. onsemi will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a>	
<b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b>	There is no product marking change as a result of this change	
<b>Change Category:</b>	Assembly Change	
<b>Change Sub-Category(s):</b>	Material Change, Manufacturing Process Change	
<b>Sites Affected:</b>		
<b>onsemi Sites</b>	<b>External Foundry/Subcon Sites</b>	
None	HANA Semiconductor, Thailand	
<b>Description and Purpose:</b>		
onsemi would like to inform customers for qualification change in epoxy material including the process flow for support this material change as following table. The others material is the same:		
	<b>Before Change Description</b>	<b>After Change Description</b>
Die Attach	QMI519 and ABLETHERM 8600	Conductive Die Attach Film 515
Other Changes	Dispensing epoxy at Die attach process	Die Attach Film laminate before Wafer saw process
There is no product marking change as a result of this change		



# Final Product/Process Change Notification

Document #: FPCN23850X

Issue Date: 20 Oct 2021

## Reliability Data Summary:

RMS F76147 HANA WDFN8 FDMS2672 Epoxy to CDAF515 Qual Report\_rev O

QV DEVICE NAME: FDMS2672

RMS #: F76147

PACKAGE: WDFN8

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0 / 231
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0 / 231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0 / 231
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 29.7 psi, unbiased	96 hrs	0 / 231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2.0 min	15000 cyc	0 / 120
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C, 3X reflow		0 / 813
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0 / 90
DPA	AEC - Q101-004	Destructive Physical Analysis - following HAST 96hrs and TC 500 cycles		0 / 6
CDPA	AEC - 006	Custom Destructive Physical Analysis – X section, following TC 500cycles		0 / 6

## Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

## List of Affected Parts:

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FDMC6679AZ	FDMS2672
FDMS2572	FDMS2672
FDMS2672	FDMS2672

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。

変更件名:	HANA (タイ) における大きなダイサイズの CDAF の 認定										
初回出荷予定日:	2022 年 1 月 27 日またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.										
連絡先情報:	現地のオンセミ営業所または < <a href="mailto:Naruedol.Srisamran@onsemi.com">Naruedol.Srisamran@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。										
サンプル::	現地のオンセミ営業所または < <a href="mailto:PCN.Samples@onsemi.com">PCN.Samples@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回 PCN または最終 PCN の最初の通知の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。										
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオンセミ営業所または < <a href="mailto:Lalan.Ortega@onsemi.com">Lalan.Ortega@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。										
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オンセミは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、< <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> > 宛てにお願いします。										
変更部品の識別:	今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。										
変更カテゴリ:	組立の変更										
変更サブカテゴリ:	材料の変更、製造プロセスの変更										
影響を受ける拠点:											
オンセミ拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:										
無し	HANA Semiconductor, Thailand										
説明および目的:	<p>オンセミは、以下の表に示すように、エポキシ材料の変更の認定、およびそれに対応するためのプロセスフローの変更について、お客様にお知らせいたします。その他の材料に変更はありません。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダイ接着剤</td> <td>QMI519 and ABLETHERM 8600</td> <td>Conductive Die Attach Film 515</td> </tr> <tr> <td>その他の変更</td> <td>Dispensing epoxy at Die attach process</td> <td>Die Attach Film laminate before Wafer saw process</td> </tr> </tbody> </table> <p>今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。</p>			変更前の表記	変更後の表記	ダイ接着剤	QMI519 and ABLETHERM 8600	Conductive Die Attach Film 515	その他の変更	Dispensing epoxy at Die attach process	Die Attach Film laminate before Wafer saw process
	変更前の表記	変更後の表記									
ダイ接着剤	QMI519 and ABLETHERM 8600	Conductive Die Attach Film 515									
その他の変更	Dispensing epoxy at Die attach process	Die Attach Film laminate before Wafer saw process									

信頼性データの要約:

RMS F76147 HANA WDFN8 FDMS2672 Epoxy to CDAF515 Qual Report\_rev O

デバイス名: FDMS2672

RMS: F76147

パッケージ: WDFN8

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0 / 231
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0 / 231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0 / 231
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 29.7 psi, unbiased	96 hrs	0 / 231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2.0 min	15000 cyc	0 / 120
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C, 3X reflow		0 / 813
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0 / 90
DPA	AEC - Q101-004	Destructive Physical Analysis - following HAST 96hrs and TC 500 cycles		0 / 6
CDPA	AEC - 006	Custom Destructive Physical Analysis – X section, following TC 500cycles		0 / 6

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用デバイス
FDMC6679AZ	FDMS2672
FDMS2572	FDMS2672
FDMS2672	FDMS2672

---

**Appendix A: Changed Products**

**PCN#: FPCN23850X**  
**Issue Date: Oct 20, 2021**

---

---

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
FDMC6679AZ		FDMS2672		
FDMS2572		FDMS2672		
FDMS2672		FDMS2672		